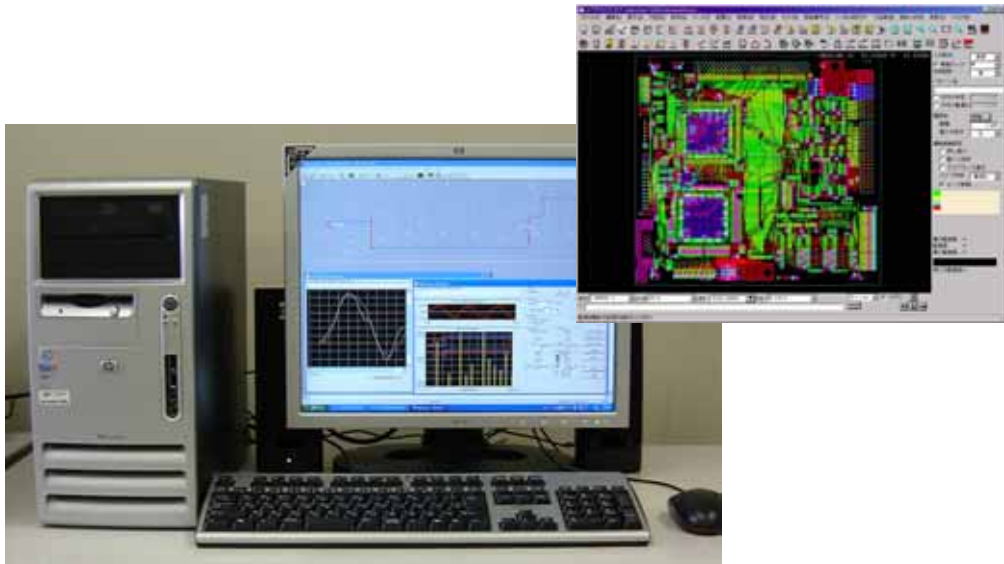


導入年度	H 1 5 年	設備名	プリント基板設計 CAD/CAE システム			
メーカー	(株)ワイ・ディ・シー	型 式	CADVANCE	設置室	開放試験室（電子）	

《 概 要 》

多層プリント基板設計を行うための CAD で、回路設計と連携した基板設計が可能
 信号品質、電磁障害 (EMI) の状況がシミュレーションで解析できるため、高品質化と雑音対策を施したプリント基板の設計に対応

《 装置外観 》



《 仕 様 》

機 能 : 回路設計 (回路図作画・編集)、基板設計 (回路設計と連携した設計、配置・配線)
 シンボル入力、ガーバー出力

最大設計層数 : 6 5 層

解析ツール : Mentor Graphics 社 (米国) Hyperlynx
 信号品質解析・電磁障害解析の各シミュレーション機能

《用途例》

- ・既設のプリント基板試作システムを利用したプリント基板の試作
- ・遅延、オーバーシュート、クロストークなどの信号品質の解析
- ・プリント基板パターンから放射される電磁障害 (EMI) の解析